

证券代码：688535

证券简称：华海诚科

## 投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	天风证券、东财证券、睿华资本、国海证券等
会议时间	2024年7月21日10:00-11:00
会议地点	线上
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：董东峰 证券事务代表：钱云 证券事务专员：张雅婷
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题一：请问贵公司产品是SRAM和HBM生产中的必需品吗？</p> <p>回复：公司主要产品包括环氧塑封料与电子胶黏剂，广泛应用于半导体封装、板级组装等应用场景。静态随机存储器芯片与高带宽存储器芯片在封装环节也会用到环氧模塑料。</p> <p>问题二：请问公司是否有材料可以应用于HBM存储产业链？</p> <p>回复：公司的颗粒状环氧塑封料（GMC）可以用于HBM的封装。相关产品已通过客户验证，现处于送样阶段。</p> <p>问题三：请问贵司GMC发展情况？</p> <p>回复：在先进封装领域，GMC产品已经在多个客户考核通过，自主研发的GMC制造专用设备已经具备量产能力并持续优化。</p> <p>问题四：公司在研“信号屏蔽及电磁干扰等器件封装”铁氧体环氧塑封料与现有通用材料相比有何优势？该材料是否可用于铜高</p>

	<p>速互联 AIPC 的电磁干扰？如果适用，即在行业风口，公司是否有计划加快研究进程？</p> <p>回复：与现有通用材料相比，铁氧体环氧塑封料的主要优势为有电磁屏蔽能力，对于 AIPC 电磁干扰，有一定的屏蔽效果，但是具体屏蔽能力暂未明确，与客户应用场景有关。该项目为定制开发项目，具体研究进程与客户进度有关。</p> <p>问题五：请问当下公司高端环氧塑封料产品能够实现国产化替代吗？</p> <p>回复：高端塑封料的技术突破到小批量出货到真正的批量需要相当长的时间，现阶段在高端塑封料领域外资仍处于主导地位，即便有部分高端塑封料实现了量产出货，但是进口替代仍然需要凭借不懈的技术开拓、稳定的产品质量、完善及时的客户服务逐步推进。</p> <p>问题六：公司有哪些产品应用于 PCB 领域？有给深南电路和沪电股份供货吗？</p> <p>回复：公司产品——电子胶黏剂可以用于 PCB 板级组装。公司与深南电路和沪电股份没有合作。</p> <p>问题七：可以介绍一下公司产品有何科技含量？</p> <p>回复：公司属于半导体封装材料行业，是典型的技术密集型行业。该行业终端应用广泛而复杂，环氧塑封料、芯片级电子胶黏剂等是保证芯片功能稳定实现的关键材料，需要跟随下游封装形式的持续演进及客户的定制化需求针对性地调整配方及生产工艺；产品研发还涉及高分子材料、有机化学、有机合成、无机非金属材料等多门学科的交叉，因此技术门槛较高。</p> <p><b>注：本次活动不涉及应当披露重大信息的特别说明，其他相关介绍、交流情况可参阅近期《投资者关系活动记录表》之内容和已对外披露正式公告。</b></p>
附件清单（如有）	无

日期	2024年7月23日
----	------------